

R.O.C Patent No. 560,697

Title: Structure of SMD LED

Summary:

The utility discloses the structure of surface mounted diode LED which

5 comprises a printed circuit board (PCB) and there is a metal reflective cup set on the PCB, and then at least one LED chip mounted on the surface of cup to result in forming a electrically connection between the LED chip and the PCB. Wherein the LED chip is enveloped with packaging glue above the PCB as the required pattern, furthermore, the packaging glue is casted on the PCB unitized. Thus, the packaging

10 glue will not fall off anyway, and then the device can reflect the light adequately.

公告本

91.12.13.

申請日期：	91.11.26	IPC分類	
申請案號：	91219022		401L 23/31

(以上各欄由本局填註)

新型專利說明書

560697

此項專利申請，本案修正後是否變更原實質內容。

一、 新型名稱	中文	表面黏著型發光二極體之結構	智慧局資料中心所提供的資料，請參照，並請洽本局，以獲取進一步的資訊。
	英文		
二、 創作人 (共1人)	姓名 (中文)	1. 林榮淦	智慧局資料中心所提供的資料，請參照，並請洽本局，以獲取進一步的資訊。
	姓名 (英文)	1.	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所 (中 文)	1. 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路56號	
	住居所 (英 文)	1.	
三、 申請人 (共1人)	名稱或 姓名 (中文)	1. 玄基光電半導體股份有限公司	智慧財產局審查組 13
	名稱或 姓名 (英文)	1.	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所 (營業所) (中 文)	1. 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路56號 (本地址與前向貴局申請者相同)	
	住居所 (營業所) (英 文)	1.	
	代表人 (中文)	1. 黃恆俊	
	代表人 (英文)	1.	

